Студент: Исмаилов М.Р. ИУ4-52Б

Семинар №5

Выбранная технология изготовления ДПП: химический негативный метод

Заданный материал основания ПП СФ 2-18-1,5

Эскизы этапов производства ПП:

Входной контроль и термостабилизация диэлектрика	
Раскрой материала	Групповая Едяничная заготовка ПП
Получение заготовок и фиксирующих (базовых) отверстий	Технологическое поле Базовые отверстия
Подготовка поверхности заготовки	
Получение защитного рельефа	Защитный рельеф
Сушка	
Травление меди с пробельных мест	
Удаление защитного рельефа	
Получение монтажных отверстий	
Нанесение паяльных маски	Прядыная моска
Сушка	

Расчет ширины печатного проводника:

Заданные параметры работы ячейки:

 $Imax = \underline{0,125 \text{ A}}$ Uдоп = $\underline{220B}$ 1 = $\underline{120mm}$ Класс точности $\underline{4}$

Imax — максимальный постоянный ток, протекающий в печатных проводниках

Uдоп – допустимое рабочее напряжение

l – максимально допустимая длина проводника

ρ – удельное сопротивление слоя меди

 t_{minD} -минимально допустимая ширина проводника

$$t_{minD} = \frac{I_{max} l \sum_{i=1}^{k} \frac{\rho_i}{h_i}}{U_{\text{доп}}}$$

 $t_{minD} = 1.3 \text{ MM}$

$$t = t_{minD} + |\Delta t_{H.o.}| = 1.33 \text{ MM}$$